

2013年度
上期

株主通信

2013年4月1日から2013年9月30日まで



ごあいさつ

**株主の皆様には、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
2013年度上期株主通信をお届けするにあたり、
謹んでご挨拶申し上げます。
当上期の事業概況につきましてご報告申し上げます。**

代表取締役会長兼 CEO

作田 久男



当上期の連結売上高は、前年同期と比べ1.8%増加し4,169億円となりました。当社グループが推進している事業の選択と集中により、民生用電子機器向けSoCやその他売上高が減少したものの、堅調な自動車向け半導体や中小型パネル向け表示ドライバICに加え、為替レートの改善などが売上増の主な要因であります。当社グループの主力事業である半導体売上高についても、前年同期と比べ6.4%増加し3,973億円となりました。

当上期の連結営業損益は207億円の利益となり、前年同期と比べ440億円の改善となりました。為替レートの改善などにより売上高が増加したことに加え、構造改革施策の実行などにより収益構造が改善したことなどによるものです。また、当上期の連結経常損益は139億円の利益となりました。支払利息や第三者割当増資の実施に伴う株式交付費などの営業外費用を93億円計上した結果、営業外損益が68億円の損失となったことによるものです。連結四半期純損益については、事業構造改善費用を中心とした特別損失を279億円計上したことなどにより、

128億円の損失となりました。

また、当社は本年度より連結業績予想の開示方法を変更いたしましたのでご案内いたします。当社は従来、第2四半期(累計)および通期の連結業績予想を開示しておりましたが、当社グループが属する半導体業界では事業環境が短期間に大きく変化するという特徴があり、通期の業績予想について信頼性の高い数値を、的確に算出することが困難であることから、本年度より、海外の多くの同業他社が採用している四半期ごとの連結業績予想を開示する方法に変更いたしました。今後の業績予想発表につきましては、四半期ごとの決算発表時に、翌四半期までの業績予想を公表いたします。

■ 配当未実施のお詫び

中間配当の実施につきましては、誠に遺憾ではございますが、平成25年3月期末時点の利益剰余金がマイナスであることから、見送らせていただくことといたしました。株主の皆様のご期待に添えず、深くお詫び申し上げます。今

後とも全社を挙げて、配当の再開に向け、業績および財政状態の改善に努めてまいります。期末配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。

■ ルネサスの変革に向けて

私が当社の会長兼 CEO に就任してから約 4 ヶ月が経過しました。就任直後に変革プランの検討を開始し、幹部や従業員と徹底的に議論を行ってきましたが、その中で私が感じた当社グループの課題は大きく三つあります。

一つ目は「マーケットイン志向」、つまりお客様が今求めている製品をいち早く把握し、タイムリーに開発・販売すること、二つ目は、「徹底した収益志向、意思決定の迅速化など内部運営の改善」、三つ目は「更に強固な財務体質の構築」です。これらの課題を解決するため、当社グループが注力すべき事業ドメインの変革や構造改革、組織の改編を軸としたフレームワークを 4 ヶ月間で策定し、10月からその実行フェーズに入っています。

特に最大の目標である収益力の向上に向けて、利益率の高い製品の比率を高める製品ミックスの改善、設計・生産拠点の再編・効率化などによる固定費の削減に加え、資材費の共通化・標準化などを通じた変動費の抑制を図ってまいります。また、事業ドメインを従来のプロダクト軸からアプリケーション軸へ変更し、市場ニーズに合わせて最適なソリューションを提供することで、お客様に提供する付加価値を高め、国内外でお客様の基盤を広げてまいります。

これに加え、今般新しく設定した目標に適した運営体制を構築すべく、組織を改編いたします。販売について

は、欧米の販売会社をそれぞれエリア統括拠点に据え、権限委譲を進めると共に、収益責任を明確化いたします。アジアについても、近いうちに中国、ASEAN の販売会社を同様に変革し、日本を含め、世界 5 極体制といたします。生産については、前工程と後工程をそれぞれ 1 つの生産子会社に集約し、収益志向を徹底しながら自律経営化を進めてまいります。

更に、従来のルネサスにない視点を取り入れるため、多様性のある新たなリーダーの登用を行いました。具体的には、グローバルでの拡販体制を強化するため、欧米販売子会社のトップ 2 名を外国人として初めて当社の執行役員に任命したほか、海外の競合他社を含むエレクトロニクス業界で豊富な経験を有する高橋恒雄氏を CSMO (Chief Sales & Marketing Officer) に任命する等、執行役員全 11 名のうち 4 名をルネサス出身者でないメンバーといたしました。

最後に、当上期はこれまでの資金調達活動や構造改革効果の発現により、成長のための財務基盤を一定程度確保することができました。特に9月30日付で(株)産業革新機構および事業会社8社から 1,500 億円の第三者割当増資の払込を受け、バランスシートは大幅に改善いたしました。

当社グループは、変革プランの着実な実行により、前述した課題を乗り越え、持続的に利益を生み出し、社会に貢献する企業となるために、徹底的に収益にこだわり、2017年3月期には営業利益率 2 桁%以上を達成できるよう、全力を尽くしてまいりますので、引き続き変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

当社を取り巻く市場環境の変化

半導体事業は応用範囲が幅広く、新興国の都市化や高齢化、重要性を増すエネルギー問題、クラウドやスマートフォンの普及に伴うネットワーク化の進展といった世界的なトレンドは、当社グループが社会に貢献し、事業を拡大する大きな機会となります。

都市化・高齢化問題



新興国の都市化



インフラ需要(交通・電力・水)



高齢化(医療・セキュリティ)

エネルギー問題



再生エネルギー・スマートグリッド



低燃費車・eモビリティの普及



省エネ家電・エネルギー管理

ネットワーク化



モバイルIT環境の普及



クラウド・サービスの広がり



ネットワーク・トラフィックの急増

当社が取り組むソリューション事業の事例

左記の市場環境の変化に伴い、当社グループが注力する事業分野において、新しいニーズが生まれています。当社グループでは、こうしたお客様のニーズに応じて、デバイス、キット、プラットフォーム^(※1)という3つのソリューションを取り揃え、最適なサービスを提供することにより、付加価値を高め、顧客基盤を拡大してまいります。

次世代自動車



統合コックピット・ナビ
+ 安全運転支援



エコシステム協業

新たなeモビリティ、
新興国2輪車向け



マイコン+パワーのキットソリューション

走る・曲がる・止まる



車載マイコン

アナログ・パワー半導体

産業・家電分野



産業用イーサネット



R-IN

業界標準
プラットフォーム

モータ制御向け
スマートメータ向け



マイコン+パワーのキットソリューション

産業機器向け



組込み向け汎用マイコン

パワー半導体

OA・ICT^(※2)分野



モバイル・タブレット向け
ディスプレイ



業界標準
プラットフォーム

カメラ向け(手振れ防止)



マイコン+アナログのキットソリューション

通信インフラ・オフィス機器向け



低電力SoC・ネットワークメモリ

プラットフォーム価値

エコシステム
ソフト・アプリ

キット価値

キットデバイス
システム
ノウハウ

デバイス価値

性能機能

(※1) 「デバイス」とはマイコン、アナログ、パワー半導体製品などを個別に提供する従来型のビジネスモデル、「キット」とは個別の半導体製品を組み合わせ、お客様の製品に最適化したソリューションとして提供するモデル、「プラットフォーム」とは製品の複雑化、高機能化に伴い、更にソフトウェアやIP(知的財産権)までを含めて提供するモデルを言います。

(※2) Information and Communication Technology



女子ダブルス今年も活躍！

4月23日からインドオープン2013が行われ、昨年、ロンドンオリンピックに出場した末綱・前田ペアがBWFスーパーシリーズ(*)3度目となる優勝を飾りました。



※BWFスーパーシリーズ：世界ランキング上位選手のみが参加できるオリンピックや世界選手権に次ぐ最高峰の大会



全日本総合選手権大会 準優勝 惜しくも三連覇を逃す

9月14日から16日までの3日間、長崎県時津町・長与町で行われた第65回全日本総合選手権大会では、決勝までの4試合を順当に勝ち進んだものの、決勝戦で惜しくもトヨタ自動車女子ソフトボール部に敗れ、準優勝となりました。



4月

5月 通期決算発表

6月 定期株主総会

7月

8月 第1四半期決算発表

9月



国内後工程の 3工場を譲渡

国内の3つの後工程生産拠点(函館・福井・九セミ(熊本))が営む製造事業等について、(株)ジェイデバイス様への譲渡が完了しました。自社国内拠点は高付加価値、高信頼度製品に注力し、海外生産へのシフトおよびアウトソーシングの活用を加速していくという後工程生産戦略の下、更に生産拠点の再編を進めてまいります。



スマートフォン向け光学式 手ぶれ補正用 LSI を発売

デジタルスチルカメラ向けに培ってきた光学式手ぶれ補正技術をスマートフォン向けに適用した新製品を発売しました。本製品を搭載することにより、スマートフォンのカメラでシャッターチャンスを見逃さず、高画質な動画・静止画を撮影することが可能になります。

スマホにも
光学式手ぶれ補正
LSI



ミッドレンジ向け 車載情報機器向け

当社が世界トップシェアを有するカーナビゲーションをはじめとする車載情報機器向けSoCの新製品「R-Car M2」を発売しました。本年3月に発表したハイエンド向け製品である「R-Car H2」と併せて業界をリードする製品ラインナップを提供してまいります。



早期退職優遇制度の 実施による人員構成の 最適化

収益基盤の更なる強化、意思決定の迅速化、業務の適正化・効率化等を目的とした早期退職優遇制度を実施し、応募人員2,316名が9月30日付で退職しました。他社への移籍や自然減等による減員を加えると、約3千人の人員減となりました。



子会社再編による 競争力の強化

販売子会社であったルネサスエレクトロニクス販売(株)の吸収合併や、設計・応用技術子会社、設計支援子会社、製造子会社の統合を10月1日に完了する等、競争力の更なる強化を実現するためのグループ組織再編を行いました。

アイコン説明



構造改革



新製品



シンボルスポート

10月 第2四半期決算発表

SoC「R-Car M2」を発売



第三者割当増資の 完了による 財務基盤の健全化

9月30日に(株)産業革新機構および事業会社8社から第三者割当増資に伴う1,500億円の払込が完了し、(株)産業革新機構が新たに当社の議決権の過半数を所有する大株主となりました。本増資資金を活用し、注力事業に対する投資を促進してまいります。



LTE モデム事業の 譲渡

携帯機器向けLTEモデムの研究開発を営んでいた子会社等の株式およびLTE技術に関する一部資産のブロードコム・コーポレーション様への譲渡が完了しました。同事業からの速やかな撤退により、注力事業への集中を加速してまいります。

マイコン事業

売上高
(2013年4月～9月)

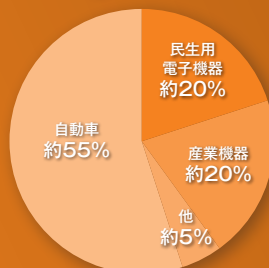
1,745億円

半導体売上高
構成比

44%

● 主な製品

マイクロコントローラ



■ 上期売上高概況

当上期におけるマイコン事業の売上高は、前年同期と比べ11.6%増加し1,745億円となりました。主に自動車向けマイコンの売上が堅調を維持したことに加え、産業機器向けマイコンおよび民生用電子機器向けマイコンの売上が増加したことによるものです。

アナログ&パワー半導体事業

売上高
(2013年4月～9月)

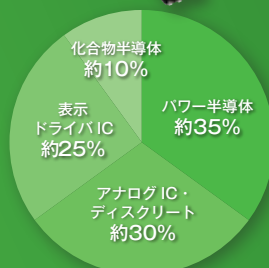
1,376億円

半導体売上高
構成比

35%

● 主な製品

パワー MOSFET、ミックスドシグナル IC、IGBT、ダイオード、小信号トランジスタ、表示ドライバ IC、化合物半導体



■ 上期売上高概況

当上期におけるアナログ&パワー半導体事業の売上高は、前年同期と比べ12.1%増加し1,376億円となりました。主に自動車向けパワー半導体、アナログ ICや、中小型パネル向け表示ドライバ ICの売上が増加したことなどによるものです。

SoC事業

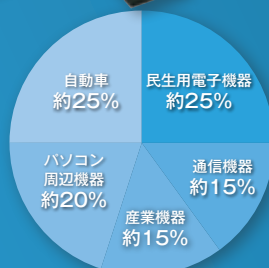
売上高
(2013年4月～9月)

822億円

半導体売上高
構成比

21%

● 主な製品

ASIC (Application Specific Integrated Circuit)、
ASSP (Application Specific Standard Product)

■ 上期売上高概況

当上期におけるSoC事業の売上高は、前年同期と比べ8.0%減少し822億円となりました。カーナビゲーションなどの自動車向け半導体の売上が増加したものの、当社が推進している事業の選択と集中により、民生用電子機器向けや携帯端末向け半導体の売上が減少したことなどによるものです。

■ 連結貸借対照表

	前年度末 (2013年3月31日)	当上期末 (2013年9月30日)
総資産	6,691 億円	7,962 億円
純資産	779 億円	2,218 億円
自己資本比率	10.0%	26.2%

■ 連結損益計算書

	前上期 (2012年4月1日から 2012年9月30日まで)	当上期 (2013年4月1日から 2013年9月30日まで)
売上高	4,094 億円	4,169 億円
半導体売上高	3,736 億円	3,973 億円
その他売上高	358 億円	195 億円
営業損益	△ 233 億円	207 億円
経常損益	△ 244 億円	139 億円
四半期純損益	△ 1,151 億円	△ 128 億円
米ドル為替レート	80 円	98 円
ユーロ為替レート	102 円	128 円

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

	前上期 (2012年4月1日から 2012年9月30日まで)	当上期 (2013年4月1日から 2013年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 135 億円	375 億円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205 億円	△ 90 億円
フリー・キャッシュ・フロー	△ 340 億円	285 億円

(注)億円未満を四捨五入して表示しております。

会社情報および株式情報

■ 会社概要

商号

ルネサスエレクトロニクス株式会社

設立

2002年11月1日
(2010年4月1日ルネサス エレクトロニクス株式会社として営業開始)

資本金

2,282億円

主な事業

各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス

従業員数(連結)

約28,500名(2013年10月1日現在)

本店所在地

神奈川県川崎市中原区下沼部 1753 番地

本社事務所

東京都千代田区大手町 2-6-2 (日本ビル)

■ 役員(2013年11月1日現在)

代表取締役会長兼 CEO

代表取締役社長兼 COO

取締役執行役員常務兼 CFO

取締役

社外取締役

社外監査役

社外監査役(非常勤)

社外監査役(非常勤)

社外監査役(非常勤)

執行役員常務 兼 CSMO

執行役員常務

執行役員常務

執行役員常務

執行役員

執行役員

執行役員兼 Renesas Electronics Europe, President

執行役員兼 Renesas Electronics America, President & CEO

作田 久 男

鶴丸 哲 哉

柴田 英 利

水垣 重 生

朝倉 陽 保

福田 和 樹

山川 洋一郎

清水 芳 信

関根 橋 武

高橋 恒 雄

横田 善 和

大村 隆 司

鈴木 俊 英

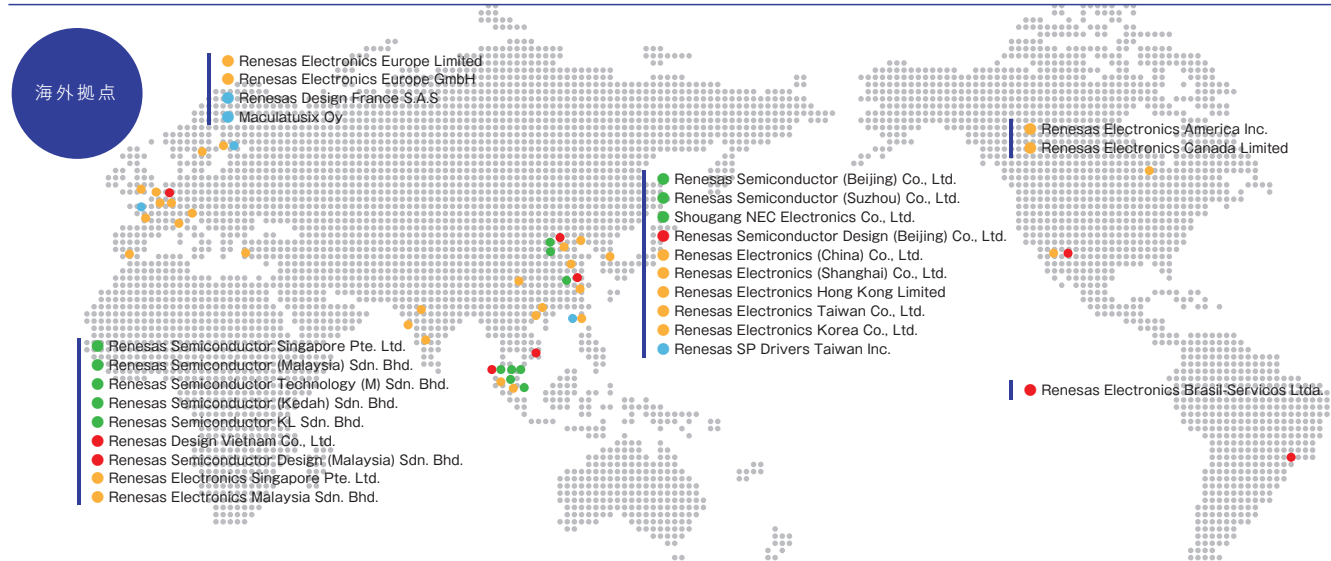
野木村 修

川嶋 学

Gerd Look

Ali Sebt

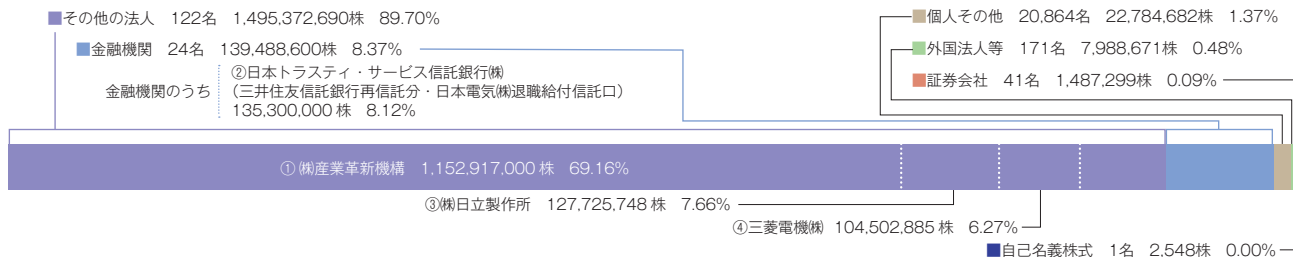
■ グローバルネットワーク(2013年10月1日現在)



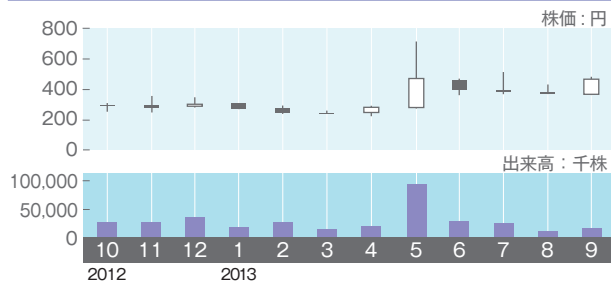
株式の状況

発行可能株式総数	3,400,000,000 株
発行済株式の総数	1,667,124,490 株
株主数	21,223 名

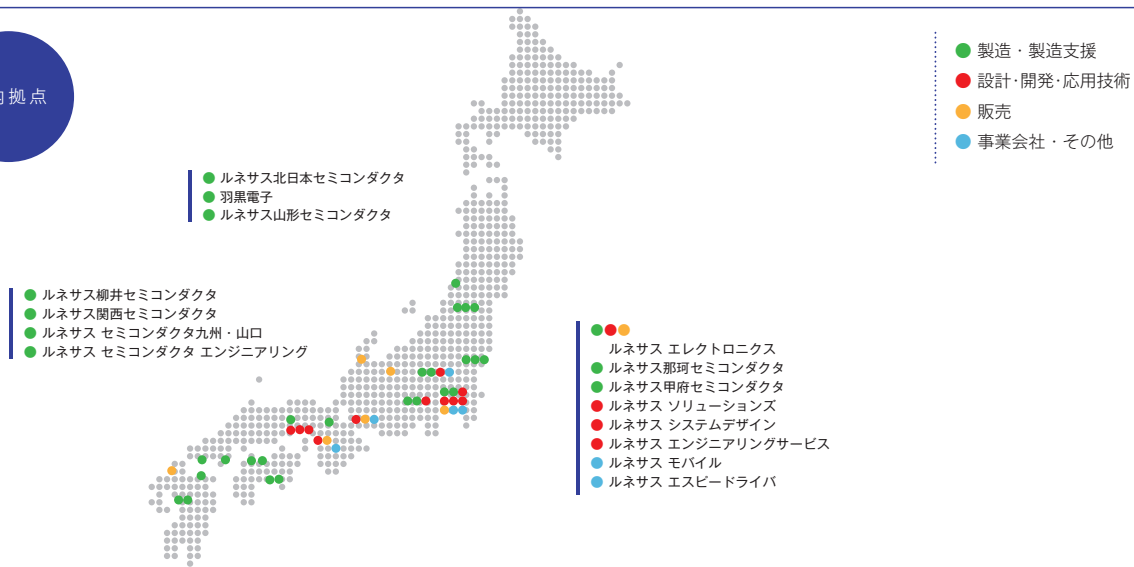
株主構成



株価チャート (2012年10月1日~2013年9月30日)



国内拠点



■ 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	事業年度の末日の翌日から起算して3か月以内
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	フリーダイヤル 0120-782-031
インターネット ホームページURL	http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
上場証券取引所	東京証券取引所

【特別口座について】

株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)をご利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である左記の三井住友信託銀行株式会社にて口座(特別口座といいます。)を開設しております。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、左記の電話照会先をお願いいたします。

IRサイトのご紹介

当社のIRサイトは、株主の皆様当社をより理解していただくため、IRサイトの見やすさ、各資料へのアクセスのしやすさを重視した作りになっております。

また、「半導体ミニ知識」のコーナーにおいて、半導体の基礎知識に関するご紹介をしております。

ぜひ、ご覧下さい。

「投資家の皆様へ(IR情報)」のアドレス

<http://japan.renesas.com/ir/>

注目トピックス

最新資料を
一括掲載

IRニュース

半導体ミニ知識



RENESAS

ルネサス エレクトロニクス株式会社
(Renesas Electronics Corporation)

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)
TEL. 03-5201-5111